

## TABLETOP-AUSSTELLUNG

Im Rahmen der Tagung wird Firmen und Instituten die Möglichkeit geboten, ihr Produkt- und Dienstleistungsangebot in einer Tabletop-Ausstellung einem breiten Fachpublikum zu präsentieren. Aufgrund der positiven Resonanz zur letzten Veranstaltung und der räumlichen Begrenzung ist es empfehlenswert, sich schon frühzeitig einen Ausstellungstisch zu reservieren: Tel. +49 (0) 211 1591 302 / -303, tagungen@dvs-hg.de

## PROGRAMMKOMMISSION

**Vorsitzender der Programmkommission**  
J. Weber, Zollner Elektronik AG, Zandt

**Wissenschaftlicher Tagungsleiter**  
K.-D. Lang, FhG-IZM, Berlin

### Mitglieder

H.-J. Albrecht, Siemens AG, Berlin  
J. Denzel, Airbus Defence and Space GmbH, Ulm  
R. Dietrich, Lackwerke Peters GmbH + Co. KG, Kempen  
M. Eisenbarth, Conti Temic microelectronic GmbH, Nürnberg  
R. Fiehler, KSG Leiterplatten GmbH, Gornsdorf  
H. Fischer, TQ-Systems GmbH, Seefeld  
J. Franke, Friedrich-Alexander Universität Erlangen  
W. Grönig, Arden-Verfahrenstechnik GmbH, Velbert  
S. Härter, Siemens AG, Erlangen  
M. Hauer, DYCONEX AG, Bassersdorf, Schweiz  
J. Kostelnik, Würth Elektronik GmbH & Co. KG, Rot  
D. Müller, VDMA e.V., Frankfurt  
J. Nicolics, Technische Universität Wien, Österreich  
M. Nowottnick, Universität Rostock  
R. Schließer, VDI/VDE-Innovation+Technik, Berlin  
G. Schmitz, Robert Bosch GmbH, Schwieberdingen  
R. Schnabel, VDE/VDI-GMM, Frankfurt  
M. Schneider-Ramelow, FhG-IZM, Berlin  
R. Schulze, BuS Elektronik GmbH & Co. KG, Riesa  
H. Schweigart, Dr. O.K. Wack Chemie GmbH, Ingolstadt  
J. Stahr, AT & S, Leoben-Hinterberg, Österreich  
H. van't Hoen, Wirges  
M. Weinhold, EIPC, Maastricht, Niederlande  
M. Weinreich, DVS e.V., Düsseldorf  
S. Weinreich, DVS e.V., Düsseldorf  
C. Weiß, ZVEI, Frankfurt  
J. Wilde, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg  
H. Wohlrabe, Technische Universität Dresden

## SPONSOREN



**DVS – Deutscher Verband  
für Schweißen und  
verwandte Verfahren e. V.**

Aachener Straße 172  
40223 Düsseldorf  
T +49. (0)211. 1591-302/-303  
F +49. (0)211. 1591-300  
tagungen@dvs-hg.de  
www.dvs-ev.de



Elektronische Baugruppen und Leiterplatten

Bild: Flexible Leiterplatte © Volker Mai, Fraunhofer IZM, Berlin



**Call for Papers**  
**Elektronische  
Baugruppen und  
Leiterplatten**  
**EBL 2018**

**Multifunktionale Aufbau- und Ver-  
bindungstechnik – Beherrschung der  
Vielfalt**

**9. DVS/GMM-Tagung**

20./21. Februar 2018,  
Schwabenlandhalle Fellbach



**GMM** VDE/VDI-GESELLSCHAFT  
MIKROELEKTRONIK, MIKROSYSTEM-  
UND FEINWERKTECHNIK

www.dvs-ev.de | www.ebl-fellbach.de

## EBL 2018 – Elektronische Baugruppen und Leiterplatten

### Multifunktionale Aufbau- und Verbindungstechnik – Beherrschung der Vielfalt

#### ZIELSETZUNG DER TAGUNG

Die Verschmelzung mit dem Endprodukt verbunden mit steigendem Bedarf nach Multifunktionalität, extremer Miniaturisierung sowie Robustheit und Langlebigkeit lassen Komplexität und technologische Vielfalt beim Aufbau elektronischer Systeme (Smart Systems) stark ansteigen. Benötigt werden dafür Aufbau- und Integrationstechnologien, die Anforderungen hinsichtlich kleinster Baugrößen, geringer Verlustleistung, großer Frequenzbereiche, hoher Zuverlässigkeit bei niedrigen Fertigungskosten und auch hoher Effizienz bei kleinen bis mittleren Stückzahlen Rechnung tragen.

Neben der ständigen Weiterentwicklung etablierter Aufbau- und Verbindungstechniken (z. B. Strukturbreitenreduzierung, Erhöhung der Funktionslagenanzahl, Kontaktstrukturen im unteren Mikrometerbereich) stehen immer mehr Strategien im Fokus, die den Aufbau aus dem Blickwinkel des Systems gestalten (z. B. System-in-Package). Beispielsweise sind das Wafer-Level-Packaging und das Panel-Level-Packaging hier zwei grundlegende, erfolgversprechende Systemintegrationstechnologien, die als Plattform zum Aufbau von komplexen, multifunktionalen Systemen sehr gut geeignet sind. Der aktuelle technologische Entwicklungsstand umfasst in diesem Zusammenhang hochwertige Kontaktierungstechniken (z. B. Mikrobumps), angepasste Umverdrahtungen (z. B. für das Fan-out-Packaging) sowie Integrationsprozesse für aktive und passive Bauelemente (Embedding) in Dünnschichtstrukturen oder die Leiterplatte. Weitere Schritte der Integration zielen intensiv auf die Nutzung dieser Verfahren zum Aufbau der Systeme in einer dreidimensionalen Art (3D-Integration). Auch ändert sich durch diese Trends die Methodik der Produktentwicklung. Die Vorgehensweise entsprechend der klassischen Wertschöpfungskette ist nicht mehr geeignet, wettbewerbsfähige Lösungen zu generieren. Anwenderindustrien wie die Kommunikations-, Medizin-, Sicherheits- oder Energietechnik müssen für zukünftige Schwerpunktthemen wie das Internet der Dinge oder Industrie 4.0 von Beginn an in die Forschungs- und Entwicklungsarbeiten der System-

integration einbezogen werden. Wegweisende Innovationen entstehen zukünftig nur noch durch intensives Zusammenwirken aller an der Wertschöpfungskette beteiligten Partner aus Industrie und Wissenschaft.

Die grundsätzliche Frage, die sich daraus ergibt:

*Ist diese funktionale und technologische Vielfalt noch strukturell, prozess-, standardisierungs- und zuverlässigkeitstechnisch zu beherrschen?*

Die Konferenz und Fachausstellung „Elektronische Baugruppen und Leiterplatten EBL“ in Fellbach, die sich als führende Präsentations- und Diskussionsplattform für Experten, aber auch Neueinsteiger auf dem Gebiet moderner Baugruppentechologien und zukünftiger Systemintegration etabliert hat, stellt sich in 2018 genau dieser Frage. Aktuelle Entwicklungsergebnisse und Praxiserfahrungen werden durch Vorträge aus Industrie und Wissenschaft präsentiert und umfassend mit den Kongressteilnehmern diskutiert. Aktuelle Geräte- und Prozessentwicklungen werden zudem parallel in der begleitenden Ausstellung demonstriert und erörtert, was zusätzlich den vertieften Erfahrungsaustausch zwischen den Teilnehmern während der 2-tägigen Veranstaltung unterstützt.

Wir freuen uns auf zahlreiche Vortragseinreichungen.

**Johann Weber**  
Vorsitzender der  
Programmkommission

**Prof. Dr. Klaus-Dieter Lang**  
Wissenschaftlicher Tagungsleiter

#### THEMEN DER TAGUNG

- Systemkonzepte, Designtools und Simulation
- Neue Materialien und Aufbaukonzepte
- Schaltungsträger
- Baugruppenmontage
- Aufbau- und Verbindungstechnik
- Prozesssicherheit und Produktprüfung
- Zuverlässigkeit und Analytik
- Packagingtrends

#### APPLIKATIONEN

- Automobilelektronik
- Industrieelektronik
- Medizintechnik
- Consumer-Elektronik
- Kommunikationstechnik
- Leistungselektronik
- Sicherheitstechnik
- Elektronik für Luft- und Raumfahrt

#### EINREICHUNG VON VORTRÄGEN

Erbeten wird eine ca. 200 Wörter umfassende Kurzfassung. Unbedingt notwendig ist die vollständige Angabe der Adresse des Autors/Vortragenden: Vorname, Name, Firma / Institut, Straße, Postleitzahl, Ort, Telefon, Fax, E-Mail.

Hierzu nutzen Sie bitte das DVS-Online-Einreichungssystem unter:  
[www.dvs-ev.de/EBL2018](http://www.dvs-ev.de/EBL2018)

Deadline für die Kurzfassungen ist der 3. Juli 2017

Die Programmkommission wählt die eingereichten Beiträge nach folgenden Kriterien aus:

- Die Arbeit ist neu und an keiner Stelle des In- und Auslands vor der Tagung veröffentlicht worden.
- Die Zielsetzung und die Ergebnisse der Arbeit und wie die Arbeit den Stand der Technik voranbringt, muss klar beschrieben sein.

Die Autoren werden benachrichtigt, ob ihr Beitrag angenommen wurde, und erhalten eine Schreibanleitung für ihr Manuskript sowie eine Dokumentvorlage, die die notwendigen Formatierungen für das Abfassen des Textes enthält.

Die Manuskripte müssen bis zum **15. November 2017** beim Veranstalter vorliegen.

Die Tagungssprache ist Deutsch. Es wird ein zitierfähiger Tagungsband erstellt, der den Teilnehmern zu Beginn der Tagung zur Verfügung gestellt wird.